



IoT 時代に向かう実装技術

～長野県内企業が取り組む新しい実装技術～

半導体産業はスケーリングの限界を迎えてもなお売上高が大きく増加している。これはこの産業がいかに広範な産業を支える基盤産業であるかを示している。また、これは同時に半導体技術にはまだ手付かずの広い応用分野が残っていることをも示している。半導体技術のロードマップ ITRS2.0 はこの考え方に立って IoT を中心とする半導体のアプリケーションから半導体技術の展開方向をとらえ直す方向に転じている。

今回の長野実装フォーラムでは IoT = Hyper Connected World ととらえ、今後の IoT 社会の在り方を概説したうえで、これを構成する基礎技術としての実装技術や新しい機器開発の方向性をテーマに取り上げる。幸いなことに、長野県内企業や大学において新しいパッケージや実装技術の開発が行われ、実用化が進んでいる。また、“マイチップ”を搭載した機器開発も行われている。これは産学官連携研究の成果として、作って、使うマイチップが、その実装技術によって新しい機器の創出につながる実例である。

今回のフォーラムでは、是非県内企業を中心とする技術開発の動向に触れていただき、IoT 時代の半導体技術に新しいアイデアを生み出す機会となるよう、多くの皆様のご参加をお待ちしています。

主 催 長野実装フォーラム、公益財団法人 長野県テクノ財団

協 賛 EPTA

【日 時】 2018年 1月26日 (金) 12:50 ~ 16:50

【会 場】 ホテルメルパルク長野 3階 白鳳 (長野市鶴賀高畑 752-8) 電話 026-225-7800

※ 長野新幹線 長野駅東口から徒歩 5分 <https://www.mielparque.jp/nagano/access/>

【プログラム】

12:50	開会挨拶 長野実装フォーラム (NJF) 代表 若林 信一
13:00	1. IoT = Hyper Connected World 長野実装フォーラム理事 横内 貴志男 氏
13:30	2. FO パッケージの現状とボール搭載技術 アスリート FA(株) 開発部 山岸 昭隆 氏
14:00	3. 薄膜キャパシタ内蔵基板 GigaModule-EC の動向 富士通インターコネクテックテクノロジーズ(株) ビジネス開発統括部 ビジネス開発室 飯島 和彦 氏
14:30	4. 部品内蔵パッケージ MCEP® (Molded Core embedded Package) 新光電気工業(株) 開発統括部 第二商品開発部 田中 功一 氏
15:00	< 休 憩 >
15:10	5. POL-KW 高出力パワー半導体向けパッケージ 新光電気工業(株) 開発統括部 第三商品開発部 林部 真悟 氏
15:40	6. 高性能電力変換システムを実現するパワーデバイス実装技術 富士電機(株) 電子デバイス事業本部 開発統括部 パッケージ開発部 SiC モジュール課 両角 朗 氏

16:10	7. 発汗センサーの開発 信州大学工学部 電子情報システム工学科 上口 光 氏
16:40	閉 会

【参加費】 8,000円

※ 参加費は、当日支払(現金) をお願い致します。

【申込方法】 1月19日(金)までに 電子メール でお申し込みください。

【申込先】 長野実装フォーラム事務局
E-mail : mchino@valley.ne.jp

【お問合せ先】 長野実装フォーラム庶務理事 手塚 佳夫
E-mail : tezuka@valley.ne.jp TEL : 090-4230-9187

第31回 長野実装フォーラム(1/26)参加申し込み

◀申込先：電子メール▶ mchino@valley.ne.jp

※ 氏名／勤務先／所属／住所／TEL／E-mail をご連絡ください。

フリガナ 氏 名	参加費	8,000 円 (当日現金払)
勤務先 所属部署 (役職)		
〒 住 所		
連絡先	TEL :	E-mail :